

证券代码：603388

证券简称：元成股份

## 元成环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	韦豪创芯：刘夏雨、刘歆宜 广发证券：叶秀贤、焦鼎
时间	2023年3月14日
地点	硅密(常州)电子设备有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长 祝昌人 硅密(常州)电子设备有限公司 刘毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 市场定位及在这个细分市场的优势？</p> <p>经过多年的技术开发和工艺积累，目前公司已掌握从2英寸到12英寸各种尺寸晶圆的槽式湿法清洗及刻蚀设备的技术路线，公司目前也已储备了单片清洗技术。公司目前主要聚焦在半导体材料（抛光片）领域，以槽式湿法清洗设备为主，公司下游主要客户为有研硅、麦斯克、浙大海纳等知名抛光片厂商，并保持长期合作关系。公司在半导体IC晶圆制造、半导体先进衬底材料、蓝宝石衬底、LED芯片制造、光伏等领域也成功开发了多家国内知名客户，主要有华润上华、士兰微子公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、滁州华瑞微、天合光能等。同时，公司业务还拓展至高纯石英部件清洗设备、先进封装湿法设备、光伏湿法设备、化学品供应系统等相关领域。</p> <p>2. 公司的核心竞争力？</p> <p>首先，公司核心技术工程师和生产技师服务团队稳定，通过多年在行业内的开拓与发展，吸收国外先进的湿法工艺设备设计和制造技术，通过自主研发和创新，申请了多项发明专利和实用新型技术</p>

专利，并在设备控制软件上完全自主设计，取得了软件著作权证书。目前积累了半导体设备设计和制造的相关经验和技能，成功应用在国内多家知名客户的核心工艺工序上，这些核心技术均在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户和合作伙伴。

其次，在内部管理上，公司采用标准化的理念和手段去设计和制造非标设备，缩短生产周期、减少设计错误、提高设备的稳定性和维护的便捷性。其中，公司模块化的软硬件设计、全 PC 控制软件、精准的模拟量称量配液系统、多尺寸兼容的机械手结构、精准工艺温度控制技术等的成功应用，为不同客户带来了切实的效果，提升了工艺水平和产品良率、提高了设备产能、大幅降低了客户固定资产投资成本和生产运营成本。

目前公司已经有适用于材料领域 8 英寸晶圆产品清洗的全自动生产线。

### 3. 公司研发团队是什么样的背景及组成？

公司创始人、技术总监 Carl Huster 博士毕业于美国 Purdue 大学电子工程专业，曾就职于美国 AMD 公司研发部从事存储器产品开发。公司创始人、总经理 汪燕女士，硕士毕业于美国 Purdue 大学电子工程系，曾就职于美国 IBM 公司。研发是由机械和电气、软件三个部门组成。

### 4. 设备的交付周期是怎么样？

设备正常交机周期 6-8 个月，安装调试 1 个月，设备硬件及工艺验收 2 个月。

### 5. 美国制裁对于产品的影响？

目前，泵、阀门、过滤器等器件确实是需要进口，但对于我们来说多个供应商分布在不同国家，出现同时断供情况概率较低，并且即使某些国家断供，其他海外供应商也能在较短周期内送达。

### 6. 未来考虑做单片吗？

主攻还是槽式清洗，不排除以后做单片。

### 7. 未来产品规划？

后续公司希望做半导体湿法高端清洗领域专家。

	<p>8. 12 寸晶圆产品清洗有实现的时间表吗？</p> <p>在硅片制造的切、磨、抛工艺流程中，目前公司已经可以提供 12 寸抛光前的清洗工艺设备。</p> <p>12 寸抛光后的清洗工艺，现在基本上是海外供应商在做，公司规划在 2024 年完成 12 寸的全流程清洗工艺设备的开发。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 3 月 14 日